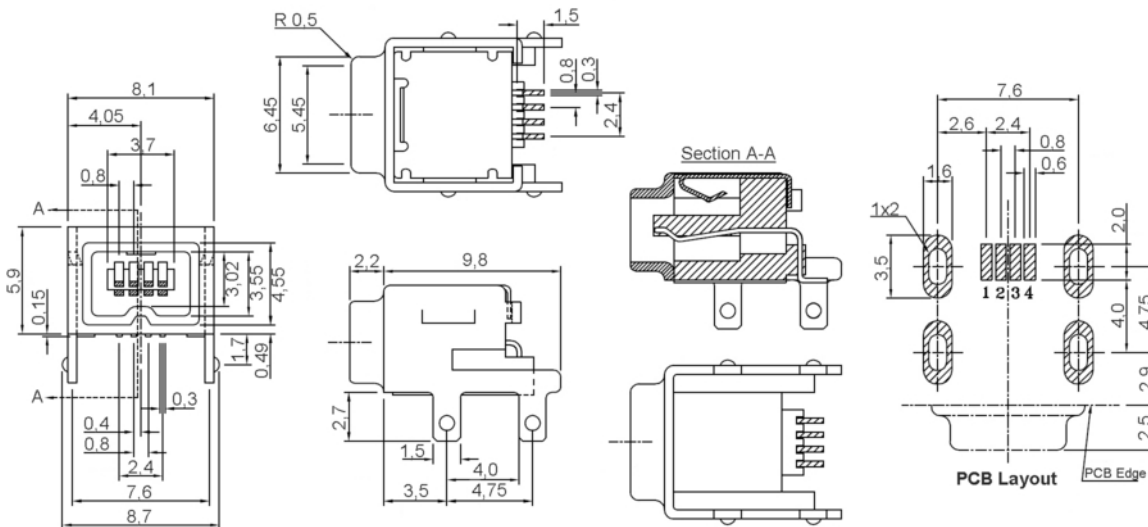


Technische Daten / Technical Data

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäuse | Vorderes Gehäuse: Stahl, verzinkt Hinteres Gehäuse: Messing, verzinkt |
| Shell | Front shell: Tin plated steel Rear Shell: Tin plated brass |
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Farbe | Schwarz |
| Colour | Black |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Contact Material | Copper alloy |
| Kontaktfläche | Gold über Nickel (siehe Optionen unten) |
| Contact Surface | Gold over nickel (see options below) |
| Oberfläche Lötanschluss | Zinn über Nickel |
| Plating Solder Side | Tin plated over nickel |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Solderability | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 30mΩ |
| Contact Resistance | < 30mΩ |
| Isolationswiderstand | > 500MΩ |
| Insulation Resistance | > 500MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500V _{AC} |
| Test Voltage | 500V _{AC} |
| Nennspannung | 50V _{AC} |
| Voltage Rating | 50V _{AC} |
| Nennstrom | 1A |
| Current Rating | 1A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +105°C |
| Temperature Range | -40°C ... +105°C |
| Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren |
| Processing | Reflow soldering |



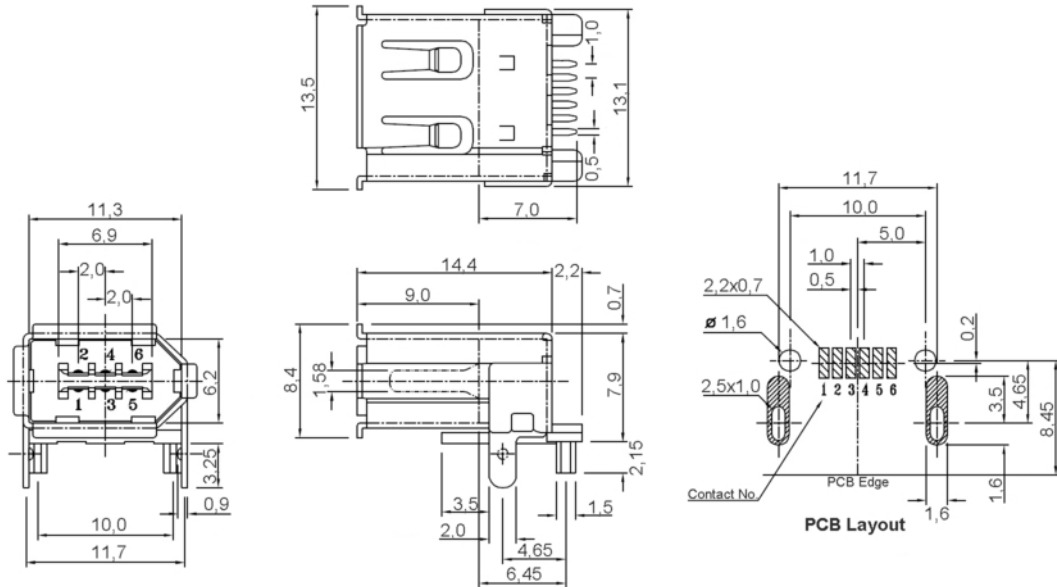
© W+P PRODUCTS



| | | | |
|---------------|-----------------|---|---|
| Series | Contacts | Type | Plating* |
| 8410 | 04 | 1 | 60 |
| | | 1 SMT horizontal, gewinkelt SMT horizontal, right angled | 60 Sel. Au/Sn Duplex plating 80 Sel. Au 0,75µm / Sn |

8410

SMT-IEEE 1394 Steckverbinder, liegend
SMT IEEE 1394 Connectors, Horizontal



Series

8410

Contacts

06

Type

1

1 SMT liegend
SMT horizontal

Plating*

60

60 Sel. Au/Sn
Duplex plating
80 Sel. Au 0,75µm / Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Reflow-Löttempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150°C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200°C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217°C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260°C ±5 |
| Dauer Höchsttemperatur | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P | Max. 8 min |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150°C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200°C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217°C |
| Duration above T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Peak Temperature T_P | 260°C ±5 |
| Duration Peak Temperature | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | Max. 8min |

